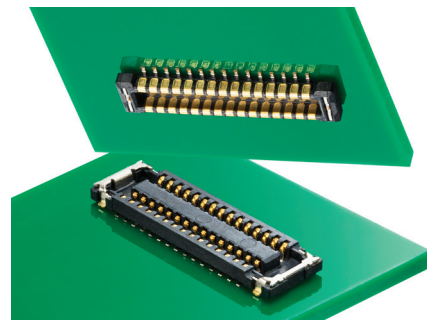


SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距，B8系列

molex

0.40毫米端子间距，0.80毫米高度，带CleanPoint接点设计的SlimStack B8连接器具有强大的功能，可避免污染物存留在接点上，并可耐受粗暴对待。

未来设备越来越贵重复杂，设计人员需要提供连接稳定的产品，以避免昂贵的返工和/或维修。为各种设备设计可靠的连接器至关重要。在生产柔性板与电路板之间的跳线过程中，助焊剂或灰尘有时会沉积在触点上造成信号电路接触不良。Molex B8系列连接器采用CleanPoint接点设计。CleanPoint接点是斜面形接点，不会存留助焊剂和其它污染物，从而提供更稳定的电信号连接。

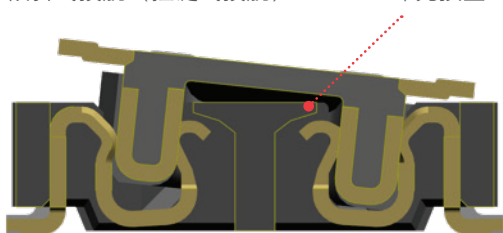


特点和优点

外壳顶壁

外壳顶壁（止档）可防止连接器在被倾斜拔脱时端子翘起

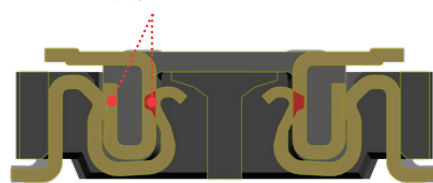
倾斜式拔脱（拉链式拔脱） 外壳顶壁



双触点设计

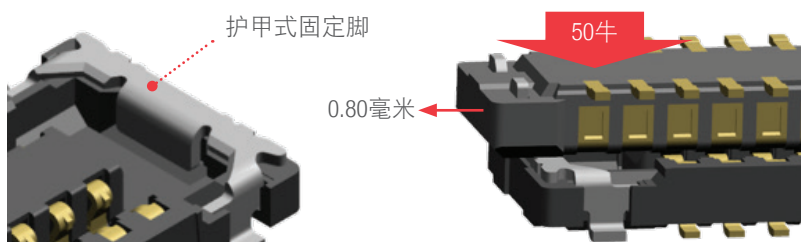
Molex SlimStack B8系列连接器采用双触点设计，可化解因跌落和冲击造成的接触不良问题，甚至在设备处于严苛环境下也能保持信号的稳定连接

双触点



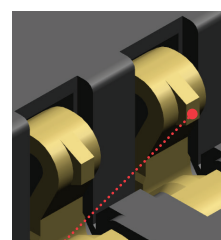
护甲式固定脚

护甲式固定脚可在盲配或倾斜拔脱（拉链式拔脱）时保护外壳免受损坏。为测试Molex B8连接器外壁承受力进行的对配测试表明，在对外壳施加高达50牛的力且对配误差在0.80毫米的情况下，外壳未出现损坏。



SlimStack B8 CleanPoint接点

Molex的CleanPoint接点设计提供卓越的电气可靠性，并且不会滞留除焊剂等异物



CleanPoint接点

应用场合

移动设备

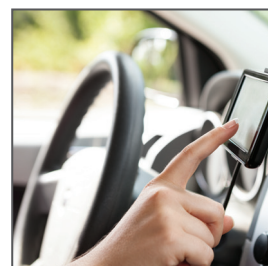
- 智能手机
- 平板电脑
- 可穿戴设备
- 便携式音频
- 便携式导航设备



智能手机



可穿戴式设备



便携式导航设备

SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距，B8系列

molex

产品规格

参考信息

包装：器件承载卷带
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤：低卤素

电气参数

电压（最大值）：50伏
电流（最大值）：每路0.3安
接触电阻（最大值）：80毫欧
绝缘耐压：250伏交流
绝缘电阻（最小值）：100兆欧

机械参数

可插拔次数（最小值）：30次

物理参数

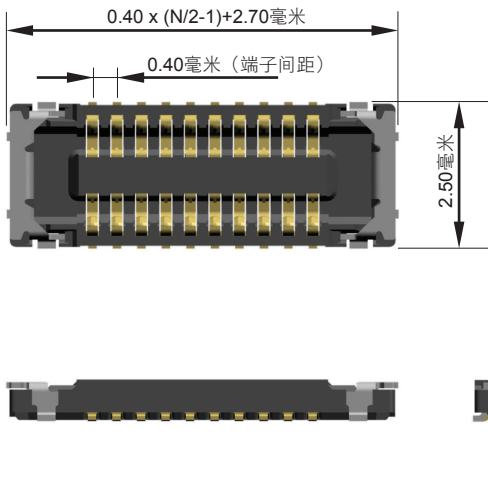
外壳：LCP，UL 94V-0，黑色
接点：铜合金
电镀：
接点部位 - 镀金
焊尾部位 - 镀金
底层电镀 - 镀镍
工作温度：-40至+85摄氏度

外形尺寸

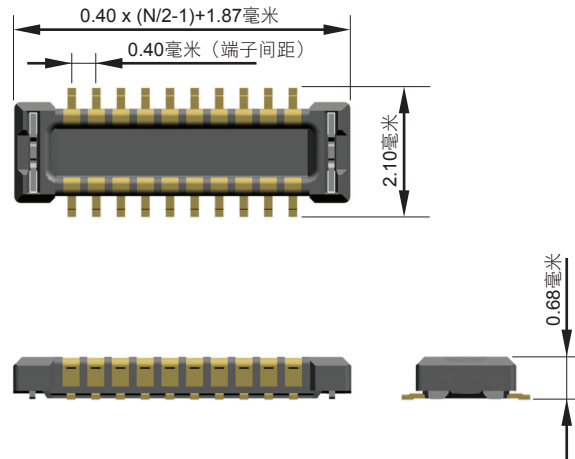
* 欲知详细尺寸，请参阅图纸

N: 电路数量

插座



插头



订购信息

订购号		描述	对配高度 (毫米)	对配宽度 (毫米)	电路数量
插座	插头				
505550 -**20	505551 -**20	在该连接器中， 护甲边缘位于外壳边缘内	0.80	2.50	10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50

**：电路数量

www.molex.com/link/slimstack.html
www.chinese.molex.com/link/slimstack.html

MOLEX是MOLEX有限责任公司在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。